

1名分料金で
2人目無料

半導体封止材の基礎と最新開発動向

【LIVE配信】

◆日時: 2026年6月25日(木) 13:00~15:00

◆会場: 自宅や職場など世界中どこでも受講可

◆聴講料: 1名につき33,000円(税込、資料付)

※会員登録(無料)をしていただいた方には下記の割引・特典を適用します。

・1名でお申し込みされた場合、1名につき27,500円(税込)

・2名同時でお申し込みされた場合、2人目は無料(2名で33,000円(税込))

セミナーお申込みFAX

03-5857-4812

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

●講師: (株)レゾナック エレクトロニクス事業本部 開発センター 封止材料開発部 中村 真也 氏

【習得できる知識】

半導体封止材の基礎技術からそれを応用した最近の進歩が習得でき、半導体封止材に関わる各メーカーさんの設計・改良指針等の実務に活かせる。

【趣旨】

本セミナーでは、冒頭にレゾナックの半導体封止材事業のラインナップをご紹介します。続く基礎技術パートでは、封止材の役割を起点として、固形封止材(EMC)における原材料構成や各原材料の役割、ならびに液状封止材(CUF)に要求される特性やEMCとの比較について解説します。

次に、パワー半導体向け封止材を対象として、設計方針、材料技術、評価技術について説明します。さらに封止材技術の最近の進歩として、成型方式の進化や、AIサーバー等に使用される先端PKG向け封止材の設計・改良指針について解説します。

その後、LEDリフレクター用の白色封止材やインダクター用磁性封止材など、封止材技術を応用した派生製品の設計指針をご紹介します。最後に、環境対応技術として、当社の上流および下流におけるCFP(カーボンフットプリント)低減に貢献する封止材技術と、その検討指針について解説します。

【プログラム】

1. レゾナック及びレゾナックの封止材事業のご紹介

2. 封止材の基礎技術

2-1 封止材の役割

2-2 固形封止材の基礎技術

2-3 液状封止材の基礎技術

3. パワー半導体向け封止材

3-1 パワー半導体向け封止材の設計方針

3-2 パワー半導体向け封止材の材料技術

3-3 パワー半導体向け封止材の評価技術

4. 封止材の最近の進歩

4-1 成型方式:トランスファー成形とコンプレッション成形

4-2 先端パッケージ用封止材及びその技術

5. 高熱伝導化技術

6. 封止材技術を転用した派生製品

6-1 LED用白色封止材

6-2 インダクター用磁性封止材

7. 環境対応封止材の開発動向

【質疑応答】

【LIVE配信セミナーとは?】・本セミナーは「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。「ミーティング用Zoomクライアント」をダウンロードするか、Webブラウザから参加するかの2種類がございます。ZOOM WEBセミナーのはじめかた(<http://www.rdsc.co.jp/files/instruction/zoom.pdf>)をご覧ください。

・お申込み後、受理のご連絡メールをさせていただきます。一部メールが通常セミナー形式(受講券、請求書、会場の地図)になっておりますが、LIVE配信のみのセミナーです。

・お申込み後、接続テスト用のURL(<https://zoom.us/test>)から「ミーティングテストに参加」を押していただき動作確認をお願いします。

・後日、別途視聴用のURLをメールにてご連絡申し上げます。セミナー開催日時の10分前に、視聴サイトにログインしていただき、ご視聴ください。

・セミナー資料は前日までには、お送りいたします。タブレットやスマートフォンでも視聴できます。

『半導体封止材【WEBセミナー】』セミナー申込書

会社・大学			
住所	〒		
電話番号		FAX	

お名前	所属・役職	E-Mail
①		
②		

会員登録(無料) ※案内方法を選択してください。複数選択可。

Eメール 郵送**● セミナーの受講申込みについて ●**

必要事項をご明記の上、FAXでお申込み下さい。弊社で確認後、必ず受領のご連絡をいたします。受講用URLは後日お送りいたします。

セミナーお申込み後のキャンセルは基本的にお受けしておりませんので、ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

お申込み・振込に関する詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/entry>個人情報保護方針の詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy>